

昆腾微电子股份有限公司



公司概述 - 总体

我们是一家Fabless的半导体公司, 从事模拟/混合/射频信号的集成电路设计和销售。

主要针对无线消费电子、金融安全 及智能卡芯片以及通信、工控、汽 车、医疗类芯片。

注册资金8071万元人民币,海归创立的中外合资企业。

员工108人,60%拥有硕士以上学历。完整的设计团队包括模拟、射频、数字、系统和软件等。拥有国内外专利160余件(包括已授权和在申请)。

总部及研发主体在北京市海淀区, 香港设有物流用子公司,深圳有销售和支持团队。

2006年9月在北京成立





公司概述 - 证书及奖励

- 福布斯2014中国最具潜力100强企业(第三名)
- 国家"核高基"科技重大专项承担单位 "新一代宽带无线移动通信网" "高性能数据转换器产业化"
- 国家 "863" 科技课题 "超高速光通信网络核心芯片"
- 2011、2012两届中国十大最具潜力IC设计公司奖
- 2010中国IC设计公司成就奖
- 2008、2010两届十大中国杰出服务型IC设计公司奖
- KT09xx系列荣获2010年度热门产品奖
- 2007 中国半导体创新产品和技术奖
- 2007 模拟/混合信号集成电路技术创新奖
- 国家商用密码产品生产定点及销售
- 高新技术企业
- 集成电路设计企业







公司概述 - 里程碑



2007年 第一款产品FM发射SOC量产出货

2008年 8比特2千兆模数转换器(ADC)研发成功

2009年 实现盈利

2011年 双界面金融IC卡芯片开始研发

2012年 无线音频芯片累计出货突破3亿颗

2013年 股份制企业改造完毕,股份公司成立

2015年 高速ADC在华为测试通过;

双界面银行卡芯片在BCTC测试通过,

获得相关银联及国密资质;

2016年 登陆新三板;

和英飞凌达成战略合作



公司概述 - 产品发展

12bit, 250MSPS ADC在华为测试通过; 2014 金融安全(mPOS, U盾, Mini付)的ARM M4核MCU研发及流片成功; ~15 支持银联PBOC3.0及EMVlevel 1的双界面读写卡器专用接口芯片量产;公司正式进入智能卡及安全芯片行业;获得银联PBOC3.0及国密相关资质; 双界面金融IC卡芯片在几大卡商进行测试; 2011 863超高速ADC/DAC竞标成功; 基站用超高速DAC开始出货; 核高基03专项(高速ADC/DAC)成功通过国家验收; 世界首颗100dB高动态范围单片UHF/VHF无线音频收发芯片组研制成功,实现量产; 双界面智能卡芯片研发及验证演示; 智能电网OFDM芯片组研发 模拟和数字MEMS麦克风前置放大驱动芯片成功通过山东歌尔声学测试; 2010

基站用超高速DAC流片成功; FM/AM 接收SOC量产;

FM接收SOC和触摸屏控制器量产; CMMB调谐器 + 解调器成功演示 2009

2008 2干兆8比特DAC研发成功: FM发射SOC成为市场主导产品

2006 FM发射SOC研发及量产,一年内全面击败日系垄断厂商 ~07



管理团队

- ▶ 曹靖 董事长 联合创始人,北京大学学士、美国加州大学洛杉矶分校 (UCLA)硕士,北京"海聚"人才,超过20年集成电路设计与管理经验。历任Conexant、Mindspeed高级设计工程师及项目经理职位,带领工程团队,突破多项技术难关。
- ▶ 林海青 总经理 联合创始人,清华大学学士、美国俄勒冈州立大学博士,北京"海聚"人才,超过20年集成电路设计与管理经验。历任Cadence/Tality设计经理,Solarflare 资深工程师等职位。担任GLG咨询委员会资深委员,多篇论文发表于国际顶级行业期刊与会议(ISSCC and JSSC)。
- 》 刘忠志 副总经理/CTO 清华大学学士、美国李海大学硕士,北京"海聚"人才,超过15年集成电路产品、系统固件开发经验。历任PMC-Sierra产品开发经理、固件研发经理、上海设计中心主管等职位,拥有丰富产品开发、项目管理及人事管理经验。
- ▶ **段哲明 运营副总裁** 清华大学学士、美国弗吉尼亚大学硕士。历任PMC-Sierra项目经理、资深设计工程师等职位,拥有丰富工程、运营管理经验。
- 马平西首席射频科学家北京大学博士、国家"干人计划"专家,超过20年集成电路设计与管理经验。历任瑞典皇家工学院访问学者,加州大学洛杉矶分校(UCLA)研究员,美国Conexant、Jazz半导体公司主任资深设计工程师和全球设计服务经理,深圳国民技术有限公司首席射频科学家。

Confidential

6







品质保证

- 体系认证:
 - 通过ISO9001质量管理体系认证
 - 通过ISO27001信息安全体系认证
- 产品可靠性:
 - ESD(HBM\MM), Latch-up, 高温寿命 (HTOL), 高温高湿(THT), 温度循环 (TCT), 高压锅蒸煮(PCT), 高温存储 (HTST)
- 环保要求:
 - 本公司全系列产品均遵循欧盟RoHS环 保指令
- 制程能力:
 - 本公司全系列产品晶圆均在国际知名厂 商加工,封装厂为国内知名上市公司



供应链伙伴

- Foundry:
 - TSMC, SMIC
 - 昆腾微电子是TSMC重点支持客户



The Proven Path to Success"

TERADYNE

- 测试:
 - TERADYNE (USA)
 - Credence
- 封装:
 - ASE (Taiwan), 华天, 长电等
- 可靠性测试:
 - iST (宜特,亚洲最大电子产业验证分析第三方公正实验室)













公司专利 (到15年底)



- 在申请77件中国专利
- 拥有81件中国专利授权



- 在申请4项美国专利
- 拥有4项美国专利授权

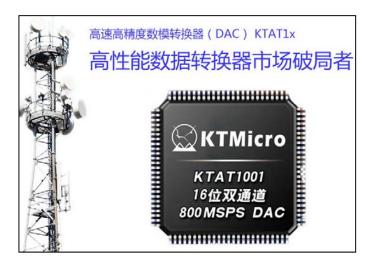


公司竞争优势

- 全面的集成电路设计技术
 - 一流的模拟、混合信号和射频电路设计技术覆盖从DC到40GHz的不同应用
 - 复杂片上系统集成(SoC)设计技术
 - MCU、安全算法、 DSP、通讯信道、音频处理等
 - 55nm至0.35um设计、流片经验
- 高效的研发设计团队
 - 多名资深海外一线经验设计人员带队,公司拥有国家干人计划专家1人,北京海聚人才4人
 - 完善的设计流程与质量控制体系
 - 按世界一流集成电路公司标准培训
- 完善的生产管理、销售支持能力
 - 运营管理能力得到超过四亿颗高质量芯片出货验证
 - 获主要供应商认可为增长潜力巨大的客户,在技术、产能、价格、商务条件等方面给予强力支持



产品方向











产品线(一)模数/数模转换芯片应用领域

- 通信
- 安防监视和控制
- 智能可穿戴
- 工业控制
- 测量
- 医疗



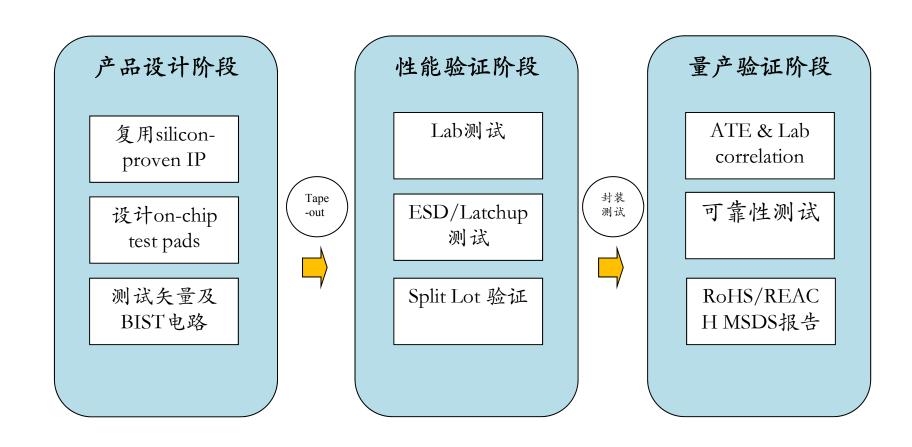
部分产品

Confidential

13



新品验证流程





可靠性测试

- ESD (CDM/HBM/MM) /Latch-up
- Precondition (预处理)
- -TCT(温度循环测试)
- PCT (饱和蒸汽试验)
- -HTST (高温贮存试验)
- Burn-in: HTOL (高温寿命试验)
- HAST (高加速寿命试验)

Confidential

15



ADC/DAC部分专利列表

		•	
1	2011100398570	用于降低电源域内的电源干扰的装置	解决跨电源域干扰问题
2	201120040331X	用于降低电源域内的电源干扰的装置	
3	2011102450593	在高速系统级芯片电路中实现数据同步的方法 和装置	
4	2011203136503	在高速系统级芯片电路中实现数据同步的装置	自动同步高速数据
5	2012201215153	实现数据同步的装置	自动同步高速数据
6	2012101771657	电容失配校正电路和电容失配校正方法	校准静态误差,包括电容和运放
7	2012202548746	电容失配校正电路	校准静态误差
8	2012102595671	数模转换器	减小Glitch对性能的影响
9	2012203629172	数模转换器	
10	2012103028758	数模转换器	校准匹配失误
11	2012204220312	数模转换器	
12	ZU1J1UUU11/4J	佚蚁节佚命及 六 上TF 71 広	提高片内参考电压驱动能力
13	ZU1JZUUU1 1 07J	沃	
14	ZU131U11111Z A	刀大电谷空儿牧品旳大师仪止电哈和力広	校准静态直流偏差
15	ZU1 <i>J</i> ZU1J0UZ1/	刀大也合坐儿权命旳大师仪工也哈	

Confidential

16



产品线(二)无线SOC芯片部分应用领域

- 麦克风
 - 传统麦克风及接收机
 - "互联网+"用新型麦克风及接收机
 - 拉杆音箱用麦克风及接收
- 无人机及虚拟现实
- 智能穿戴及智能家居
- 行车记录仪
- 扩音器,导游机
- 无线音箱 (Soundbar低音炮等) 及无线耳机
- 会议系统
- Boombox,便携式及传统收音机



无线SOC部分产品系列 (-)

型号	产品描述
KT0806L	FM 发射SOC
KT0810SG	FM 接收SOC
KT0863R	FM 接收SOC
KT0913	FM/AM 接收SOC
KT0922D4	FM/AM接收
KT0923D4	FM/AM 接收SOC
KT0932	FM/AM 接收SOC
KT0936M	FM/AM 接收SOC
KT0622	VHF无线音频发射SOC
KT0612	VHF无线音频接收SOC
KT0623	UHF无线音频发射SOC
KT0613	UHF无线音频接收SOC

Confidential 18



无线SOC部分产品系列 (二)

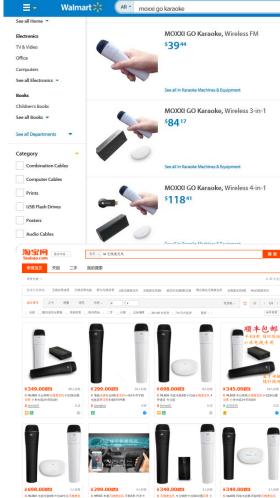
型号	产品描述
KTA3201DKI	2.4G全集成(RF+ARM M0)收发 SOC
KTA2403DDI	2.4G 收发SOC(RF Only)

Confidential 19

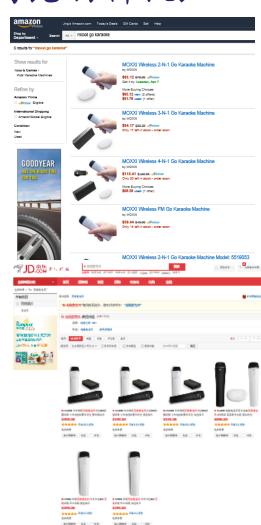


终端产品 (来自全资子公司昆羽科技)

美国 沃尔玛



美国 亚马逊



京东

Confidential

淘宝



产品线 (三)安全类芯片应用领域

- 双界面银行卡
- 智能穿戴
- 交通卡
- 教育卡
- 卫生健康卡
- mPOS, mini付主控



安全类产品

双界面 IC卡芯片 双界面 读写机具芯片

主控、安全芯片

银行卡 卫生卡 社保卡 公交卡 SIM卡

Level 1专用读写芯片 通用读卡器芯片 民用读卡器 NFC

.....

PCI POS USB-Key OTP



安全类 - 双界面金融IC卡芯片

	KTC20040	KTC20080
CPU	80251	80251
存储器	EEPROM/ROM	EEPROM/ROM
存储容量(KB)	40/320	80/320
支持界面	7816/14443A	7816/14443A
支持加密算法	DES/SM234/RSA/AES/ECC	DES/SM234/RSA/AES/ECC
应用	双界面Java卡	双界面Java卡
	提供Java VM	提供Java VM



安全类 - 小容量双界面卡芯片

	KT1408	KT1416
CPU	80251	80251
存储器	EEPROM/ROM	EEPROM/ROM
存储容量(KB)	8/48	16/48
支持界面	7816/14443A	7816/14443A
支持加密算法	DES/SM1	DES/SM1
应用	公交卡/SAM卡	公交卡/SAM卡
	可提供商用COS	可提供商用COS



安全类 - 双界面读写机具芯片

	型号	技术指标
	KT2001Q	14443A/B/7816/level 1
Reader IC		14443A/B/7816/
Reduel 10	KT2003Q	14443A
	KT2003S	14443A



安全类 - 安全主控芯片

	KT55512CU	KT551M0CU
СРИ	ARM Cortex M4	ARM Cortex M4
Memory	Flash	Flash
Density	512KB	1MB
RAM	128KB	128KB
Interface	7816/USB/GPIO /SPI/I2C/UART	7816/USB/GPIO /SPI/I2C/UART
Crypto	3DES/RSA/SM1/2/3/4	3DES/RSA/SM1/2/3/4
	PCI4.0认证	PCI4.0ப்ப்ட



总结

- 模数混合与无线射频芯片难度大,需要设计人员用有丰富的实践经验,是集成电路设计皇冠上的明珠
- 昆腾微电子拥有尖端的数模混合和全面的数字 化技术,拥有大量自主知识产权
- 昆腾微电子拥有世界领先的设计技术,坚实的运营生产能力,正在成为中国集成电路领域一个重要厂商

Confidential

27



谢谢